

株主通信 春号

2019年9月期 第1四半期業績のご報告 (2018年10月1日～2018年12月31日)



今回お届けする2019年春号より株主通信のタイトルを「接点」といたしました。「接点」の言葉には、株主の皆様をはじめ、すべてのステークホルダーの方々とより緊密な関係を構築したいという私たちの強い思いを込めました。また、当社のプローブカードは、ピンがICチップの電極に「接触」して電気信号を測る器具です。当社の経営姿勢と製品の特長を象徴する言葉として、当社では社内報にも「接点」の表題を掲げています。今後も株主の皆様と素晴らしい接点を持ち続けることができるようIR活動の一層の深化に努めてまいります。

株式会社 **日本マイクロニクス** 証券コード：6871

本株主通信は2018年9月末時点での株主の皆様にお送りいたしますことをご了承ください。

株主・投資家の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。

当第1四半期連結累計期間において、半導体市場では、車載・産業機器等向けデバイスの出荷数は伸びましたが、データセンター投資の先送り等によりDRAMやNANDの在庫が増え、販売価格下落によりメモリ市況は軟化しました。FPD市場でも、大型液晶テレビやスマートフォン等の最終アプリケーション向け需要が減少したのに対し、中国メーカーが生産量を維持したことで供給過剰となり、軟調な市況となりました。

このような状況の下、当社では、リーディングカンパニーとして、市況の変化に左右されない企業体質を目指すとともに、ニーズに即応した製品開発を促進する等、顧客との接点を大切にすることで、『MJC Future Vision*』に掲げた「市場へ安心・安全を提供する」活動に注力いたしました。

この結果、当第1四半期の業績は、売上高6,380百万円（前年同期比20.0%減）、営業利益966百万円（前年同期比11.5%減）、経常利益1,049百万円（前年同期比17.7%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益745百万円（前年同期比29.5%減）となりました。

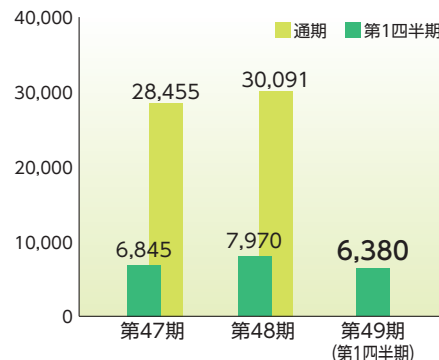
株主の皆様におかれましては、引き続き、ご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2019年3月

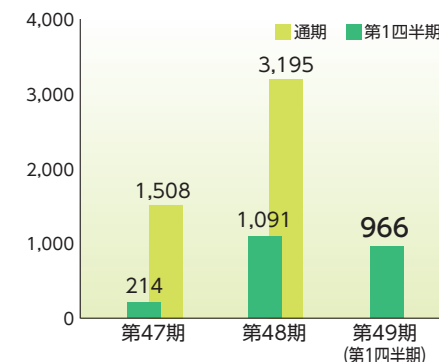
代表取締役社長
長谷川 正義

※MJC Future Vision(2017年11月公表)
品質と納期での競争力を高め、市場へ安心・安全を提供する事で『より豊かな社会の発展に貢献』することを、長期的に当社が目指す姿と定め、そのための各種重点施策をまとめたもの。

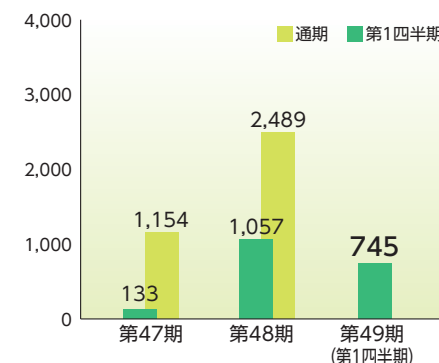
売上高(百万円)



営業利益(百万円)



親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益(百万円)

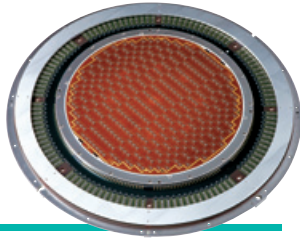


○ 営業の概況

プローブカード事業

売上高は、DRAM向け需要が活況であった前年同期と比べ下がりましたが、主要顧客の需要をしっかりと取り込んだ結果、底堅く推移しました。一方、利益面におきましては、プロダクトミックスが変化した結果、増益となりました。

この結果、売上高は5,903百万円(前年同期比11.8%減)、セグメント利益は1,685百万円(前年同期比14.2%増)となりました。



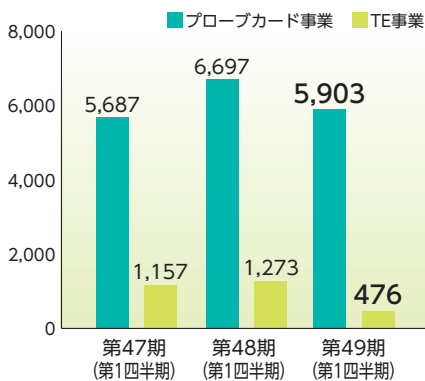
TE事業

売上高は、プローブユニットが堅調に伸びましたが、装置につきましては、LCD関連、半導体関連ともに商談が進んでいるものの、低調となりました。利益面におきましては、売上高が下がったことで減益となりました。

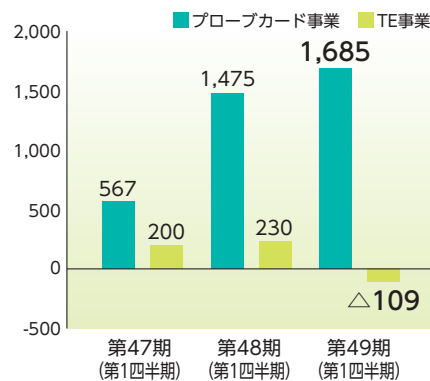
この結果、売上高は476百万円(前年同期比62.6%減)、セグメント損失は109百万円(前年同期は230百万円のセグメント利益)となりました。



○ セグメント別売上高 (百万円)



○ セグメント利益 (百万円)



※セグメント利益には、全社費用は含まれません。

○ 地域別売上高構成比 (百万円)



日本	1,425 (22.3%)
韓国	1,765 (27.7%)
台湾	1,502 (23.5%)
その他アジア	1,134 (17.8%)
欧州・米国	555 (8.7%)

○ 業績予想 (2019年2月6日現在)

売上高	営業利益	親会社株主に帰属する四半期純利益
第2四半期(累計) 14,800 百万円	第2四半期(累計) 1,600 百万円	第2四半期(累計) 1,100 百万円
第3四半期(累計) 21,100 百万円	第3四半期(累計) 1,900 百万円	第3四半期(累計) 1,300 百万円

TOPICS

「SEMICON Japan 2018」に出展しました。

2018年12月12日～14日に東京ビッグサイトで開催された「SEMICON Japan 2018」に出展し、プローブカードをはじめ、テスト、プローバ、テストソケット等の検査機器・装置を展示いたしました。本展示会は、国内外より数多くの半導体関連企業が参画する国内最大規模の業界イベントです。会場内には今後の半導体需要を牽引するロボット、IoT (Internet of Things) の他、通信速度を飛躍的に高めた次世代モバイル通信 (5G) に関する展示もあり、半導体が切り拓く未来を肌で感じさせるものでした。当社は、今後も半導体やFPDの検査ソリューションを提供することで、豊かな社会における安心・安全に寄与してまいります。



○ 株式事務についてのご案内

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
 連絡先 東京都府中市日鋼町1-1 電話0120-232-711 (通話料無料)
 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

株式会社 **日本マイクロニクス**
MICRONICS JAPAN CO., LTD.

本社 〒180-8508 東京都武蔵野市吉祥寺本町2-6-8
 HPアドレス <http://www.mjc.co.jp/>